

Global Research

Analyst 김운호

02) 6915-5656

unokim88@ibks.com

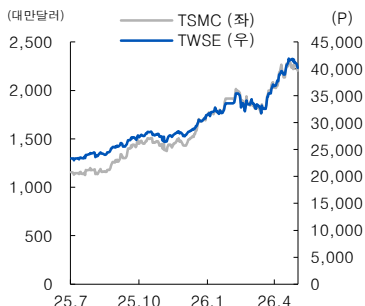
산업 분류(GICS) 반도체 & 반도체 장비
상장거래소 Taiwan

현재가 (7/17, 대만달러)	2,290.00
최고 목표가	4,200.00
최저 목표가	2,051.00
평균 목표가	3,155.24
타이완 증권거래소 가점지수 (7/17)	42,671.3pt
시가총액(대만달러)	59조대만달러
시가총액(원)	2,739조원
현재가 (7/17, 대만달러)	2,290.00
52주 최고가	2,535.00
최저가	1,115.00

주주구성	
TAIWAN SEMICONDUCTOR	20.49%
NATIONAL DEVELOPMENT FUN	6.38%

주가상승률	1M	6M	12M
상대기준	2.4%	-5.0%	17.1%
절대기준	-4.0%	32.4%	105.3%

TSMC 주가추이



본 조사분석자료는 당사 리서치본부에서 신뢰할 만한 자료 및 정보를 바탕으로 작성한 것이나 당사는 그 정확성이나 완전성을 보장할 수 없으며, 과거의 자료를 기초로 한 투자참고 자료로서 향후 추가 움직임은 과거의 패턴과 다를 수 있습니다. 고객께서는 자신의 판단과 책임 하에 종목 선택이나 투자시기에 대해 최종 결정하시기 바라며, 본 자료는 어떠한 경우에도 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.

TSMC (2330.TT)

높아진 AI 수요 대응을 위한 CAPEX 상향

5개 분기 연속 역대 분기 최대 매출 갱신

26년 2분기 매출액은 선단 공정의 강력한 수요에 힘입어 전년 동기 대비 36.0% 증가한 1조 2,704억대만달러를 기록했다. 이전 분기 대비로는 12.0% 증가했다. 영업이익은 전년 동기 대비 65.4% 증가한 7,666억대만달러, 영업이익률은 10.7%p 상승한 60.3%이다. 가동률 증가에 따른 영업레버리지 효과와 2024년 지진 관련 보험금 수익이 반영되며 영업이익률이 개선됐다.

늘어나는 수요에 대응하기 위해 신공장 증설 중

2nm·3nm 생산시설 증설을 통해 수요에 대응하고 있다. 2nm 이하 wafer 및 Advanced Packaging 생산시설 구축을 위해 미국 애리조나 주에 1,000억USD를 추가 투자할 예정이고, 3nm 공정은 대만, 미국 애리조나, 일본 각 1개씩 총 3개의 생산시설을 증설 중이다. 3nm 공정은 2027~2028년 양산이 본격화될 예정이다. 신규 공장 증설 외에도 공정 전환을 통한 Capa 확대도 이어지고 있다. 대만에서는 5nm 공정 장비를 3nm 공정 생산용으로 전환하는 작업이 진행 중이다.

투자 확대는 수요 증가를 의미

26년 3분기 매출액 가이드스는 전년 동기 대비 46.1% 증가한 1조 4,464억대만달러(±1.3%)로 제시했다. 3분기에도 선단 공정 기술에 대한 지속적인 수요가 성장을 뒷받침할 것으로 예상하기 때문이다. 영업이익률은 57.0%(±1%p)로 제시했다. 2nm 생산 확대와 해외 확장이 수익성 부담으로 작용할 전망이다.

TSMC는 2026년 CAPEX 가이드스를 600~640억USD로 4월 대비 약 80억USD 상향 조정했다. 고객사의 요청이 주 요인이다. TSMC는 신규 fab 투자 전 고객사 및 고객사의 고객과 수년 단위 로드맵을 사전 공유한다. 가시화된 수요를 근거로 투자한다는 의미이다. 선제적 투자가 아니라 수요 가시성을 기반으로 한 투자라는 점에서 중장기 실적 성장으로 이어질 가능성이 높다고 판단한다.

(단위: 백만대만달러, 배)	2023	2024	2025	2026F	2027F
매출액	2,161,736	2,894,308	3,809,054	5,362,293	7,106,872
영업이익	921,458	1,322,023	1,936,092	3,115,228	4,112,707
세전이익	973,142	1,414,769	2,050,110	3,292,163	4,275,989
당기순이익	838,498	1,173,268	1,717,883	2,713,017	3,534,908
EPS(대만달러)	32.2	45.5	66.5	105.0	135.9
증가율(%)	-18.1	41.6	46.1	58.4	29.5
영업이익률(%)	42.6	45.7	50.8	58.1	57.9
순이익률(%)	38.8	40.5	45.1	50.6	49.7
ROE(%)	26.2	30.3	35.4	40.7	39.0
PER	18.3	23.8	23.4	21.8	16.9
PBR	4.4	6.5	7.4	7.7	5.8
EV/EBITDA	10.1	13.4	14.6	14.4	10.7

자료: Company data, 예상치는 Bloomberg 컨센서스

HPC가 이끄는 실적 성장 지속

2Q26 매출액
1조 2,704억대만달러
(YoY +36.0%)

26년 2분기 매출액은 선단 공정의 강력한 수요에 힘입어 전년 동기 대비 36.0% 증가한 1조 2,704억대만달러를 기록했다. 이전 분기 대비로는 12.0% 증가했다. 영업이익은 전년 동기 대비 65.4% 증가한 7,666억대만달러, 영업이익률은 10.7%p 상승한 60.3%이다. 가동률 증가에 따른 영업레버리지 효과와 2024년 지진 관련 보험금 수익이 반영되며 영업이익률이 개선됐다.

HPC 및 Automotive의
가파른 성장세

플랫폼별로는, HPC(High Performance Computing) 및 Smartphone이 각 66%, 22%의 매출 비중을 기록했다. IoT는 5%, Automotive 4%, DCE(Digital Consumer Electronics) 1%, 그리고 기타가 2%이다. 이전 분기 대비 매출 성장률은 HPC +20%, Smartphone -4%, IoT +4%, Automotive +15%, DCE +5%, 기타 +5%이다.

2nm 공정 매출
최초 분류.
7nm 이하 공정 비중
3%p 증가

공정별로는 2nm 공정이 전체 wafer 매출의 3%를 차지했다. 2nm 공정 매출이 별도로 집계된 건 이번 분기가 최초이다. AI / HPC 등 수요 증가에 따른 미세 공정 확대를 뒷받침하는 근거라고 판단한다. 그 외 3nm 공정이 전체 wafer 매출의 30%를 차지했고, 5nm와 7nm 공정이 각 33%, 11%를 차지했다. 7nm 이하 선단 공정은 전체 wafer 매출의 77% 수준으로 이전 분기 대비 3%p 상승했다.

지역별
: 북미 78%, 아태평양 8%
등

지역별로는 북미 고객이 78%, 아시아-태평양, 중국, 일본, EMEA 지역이 각각 8%, 6%, 4%, 4% 매출 비중을 차지했다.

표 1. TSMC 실적 테이블

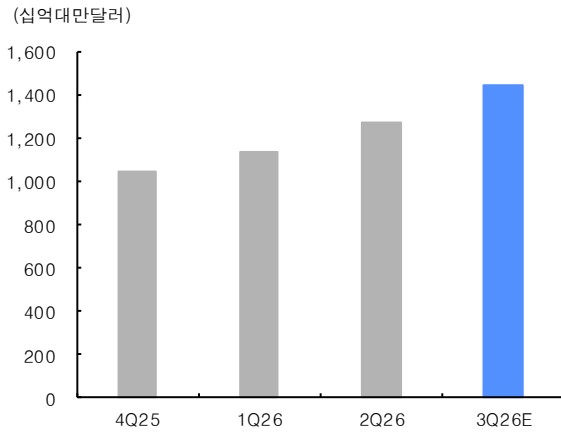
(단위: 십억대만달러)

	3Q24	4Q24	1Q25	2Q25	3Q25	4Q25	1Q26	2Q26
매출액	759.7	868.5	839.3	933.8	989.9	1,046.1	1,134.1	1,270.4
2nm	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	38.1
3nm	151.9	225.8	184.6	224.1	227.7	292.9	283.5	381.1
5nm	243.1	295.3	302.1	336.2	366.3	366.1	408.3	419.2
7nm	129.1	121.6	125.9	130.7	138.6	146.5	147.4	139.7
16/20nm	60.8	60.8	58.7	65.4	69.3	62.8	79.4	76.2
28nm 이상	174.7	165.0	167.9	177.4	188.1	177.8	215.5	254.1
YoY	39.0%	38.8%	41.6%	38.6%	30.3%	20.5%	35.1%	36.0%
2nm	-	-	-	-	-	-	-	-
3nm	363.2%	140.6%	246.2%	121.8%	49.9%	29.7%	53.6%	70.1%
5nm	20.2%	34.9%	37.8%	42.6%	50.7%	24.0%	35.1%	24.7%
7nm	47.6%	14.3%	11.8%	14.2%	7.3%	20.5%	17.1%	6.9%
16/20nm	11.2%	21.5%	10.1%	7.8%	14.0%	3.2%	35.1%	16.6%
28nm 이상	3.1%	5.5%	8.9%	9.8%	7.6%	7.8%	28.4%	43.2%
매출총이익	439.4	512.4	493.4	547.4	588.5	652.0	751.3	860.3
YoY	48.1%	54.4%	56.9%	52.8%	34.0%	27.2%	52.3%	57.2%
GPM	57.8%	59.0%	58.8%	58.6%	59.5%	62.3%	66.2%	67.7%
영업이익	360.8	425.7	407.1	463.4	500.7	564.9	659.0	766.6
YoY	58.2%	63.6%	63.5%	61.7%	38.8%	32.7%	61.9%	65.4%
OPM	47.5%	49.0%	48.5%	49.6%	50.6%	54.0%	58.1%	60.3%

자료: TSMC, IBK투자증권

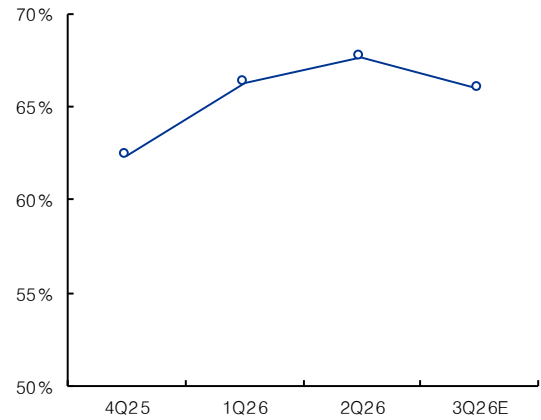
주: 세부 매출액은 공개된 매출 비중으로 재구성

그림 1. 분기별 매출액 추이 및 가이드스



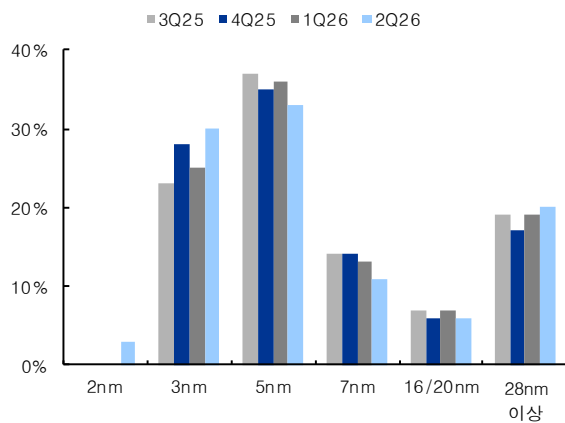
자료: TSMC, IBK투자증권

그림 2. 분기별 매출총이익률 추이 및 가이드스



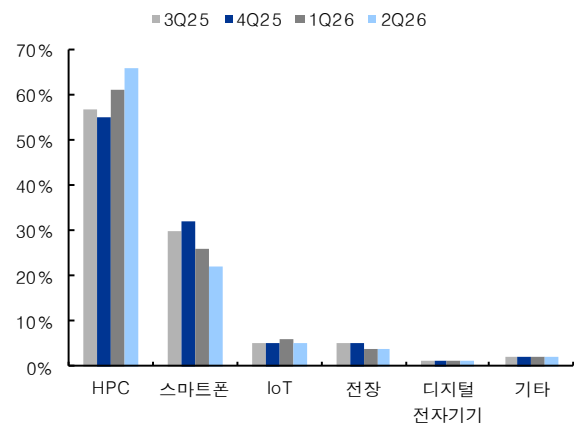
자료: TSMC, IBK투자증권

그림 3. wafer 공정별 매출 비중 추이



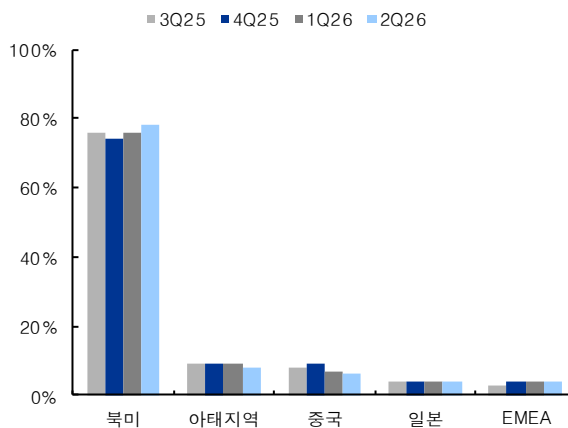
자료: TSMC, IBK투자증권

그림 4. 플랫폼별 매출 비중 추이



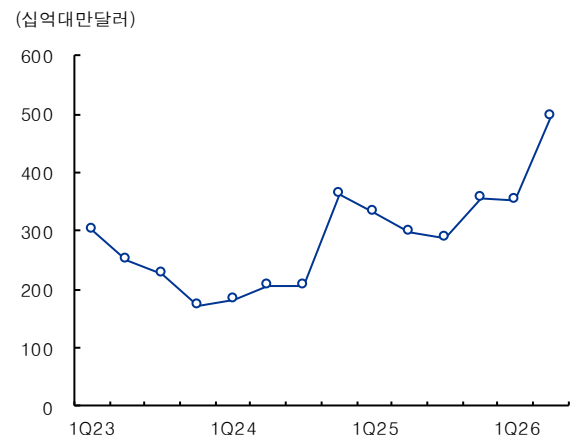
자료: TSMC, IBK투자증권

그림 5. 지역별 매출 비중 추이



자료: TSMC, IBK투자증권

그림 6. 분기별 CAPEX 추이



자료: TSMC, IBK투자증권

AI 수요 확대로 Fab도 증설

Agentic AI가 토큰
소비량을 급증시킨다

AI 관련 수요는 여전히 매우 견고한 것으로 판단한다. Generative AI에서 Agentic AI로의 전환이 토큰 소비량을 급증시키고 있기 때문이다. 토큰 소비량의 급증이 컴퓨팅 자원 필요로 이어지고, 컴퓨팅 자원 필요는 최첨단 실리콘 수요로 이어진다. Agentic AI의 등장이 CPU 중요성도 부각시키고 있는데 x86·ARM·RISC-V 기반 주요 CPU 업체 대부분이 TSMC 고객사이다. AI 메가 트렌드 속에서 TSMC의 성장세가 지속될 것으로 예상하는 이유이다. TSMC는 견조한 AI 및 선단 공정 수요를 반영해 2026년 매출 성장률 전망을 기존 30% 이상에서 USD 기준 40%를 소폭 상회하는 수준으로 상향 조정했다.

2nm Capa 확장 지속

선단 공정 Capa 확대도 지속되고 있다. 2nm 이하 wafer 및 Advanced Packaging 생산 시설 구축을 위해 미국 애리조나 주에 1,000억USD를 추가 투자할 예정이다. 이번 투자는 주요 고객사 및 미 연방 등의 지원을 바탕으로 진행된다. 장기 수요 충족을 위해 Amkor와 Advanced Packaging 10년 장기 협력 계약도 체결했다. 고객사와의 소통 후 증설을 결정함에 따라 중장기 수요 가시성이 높은 것으로 판단한다.

AI 수요 충족을 위한
3nm 공정 투자도 지속

3nm 공정은 AI 관련 수요 충족을 위해 CAPEX를 늘리고 있다. 다만, 미국 애리조나, 일본 각 1개씩 총 3개의 3nm 생산시설을 증설 중이다. 타이난 과학 단지 내 GIGA Fab 클러스터 공장은 2027년 상반기 양산을 시작할 것으로 기대되고, 애리조나 두 번째 공장은 2027년 하반기 양산 시작 예정이고, 일본 제2공장 양산은 2028년 예정이다.

공정 전환으로
Capa 확대

신규 공장 증설 외에도 공정 전환을 통한 Capa 확대도 이어지고 있다. 대만에서는 5nm 공정 장비를 3nm 공정 생산용으로 전환하는 작업이 진행 중이다. wafer 생산량을 늘리기 위해 생산성 향상에도 노력하고 있다. 3nm, 5nm, 7nm 공정 역시 생산 능력 최적화가 지속되고 있다.

A14 양산 2028년
A13·12 양산 2029년

차세대 공정인 A14 개발도 순조롭게 진행 중이다. A14는 2nm 대비 동일 전력 소비 시 10~15%의 속도 향상 또는 동일 속도 내 25~30%의 전력 효율 향상을 제공한다. 칩 밀도도 약 20% 증가한다. A14 양산은 2028년 예정이다. 지속적 성능 향상을 위해 A14의 확장 제품인 A13, A12도 공개했다. A13은 A14 대비 die 면적을 6% 이상 절감했고, A12는 성능·전력·면적(PPA) 개선을 제공한다. 두 공정 모두 2029년 양산 예정이다.

CAPEX 상향은 높은 수요 가시성을 반영

3Q26 가이드스:
매출액 1조
4,464억대만달러
OPM 57.0%

26년 3분기 매출액 가이드스는 전년 동기 대비 46.1% 증가한 1조 4,464억대만달러($\pm 1.3\%$)로 제시했다. 3분기에도 선단 공정 기술에 대한 지속적인 수요가 성장을 뒷받침할 것으로 예상하기 때문이다. 전망치인 1조 3,877억대만달러 대비 4.2% 높은 수치이다. 1달러당 32.0대만달러로 가정했다. 매출총이익률은 66.0%($\pm 1\%p$), 영업이익률은 57.0%($\pm 1\%p$)로 제시했다. 이에 따른 영업이익은 8,244억대만달러로 전망된다. 생산성 향상, 공정 간 생산능력 최적화 등 비용 개선 효과를 반영했다.

하반기 마진은 둔화될
전망

강한 선단 공정 수요와 생산 최적화 노력에도 하반기 수익성은 상반기 대비 하락할 것으로 전망된다. 2nm 초기 생산량 확대에 따라 하반기 매출총이익률이 3~4%p 희석될 것으로 예상되기 때문이다. 해외 fab 확대도 중장기 수익성 부담 요인이다. 중동 불확실성 지속과 환율도 수익성에 영향을 미칠 수 있다.

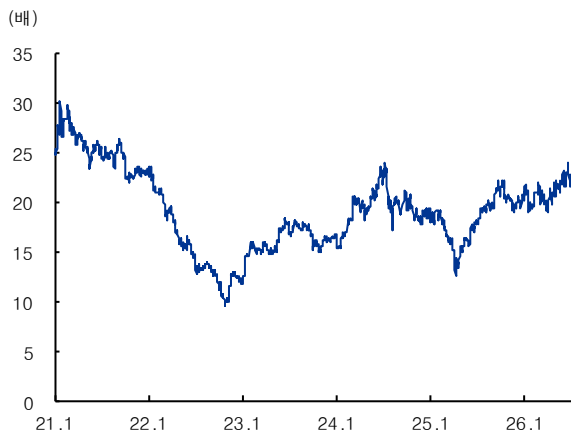
CAPEX 가이드스
4월: 520~560억USD
7월: 600~640억USD

TSMC는 2026년 CAPEX 가이드스를 4월 520~560억USD에서 600~640억USD로 80억USD 상향 조정했다. 고객사의 수요 확대에 따라 생산 능력을 확보하기 위함이다. CAPEX 중 70~80%는 선단 공정 기술에, 약 10%는 특수 기술에, 그리고 나머지 10~20%는 Advanced Packaging, 테스트, 마스크 제조 등에 투입할 계획이다.

중장기 실적으로 이어질
CAPEX 확대

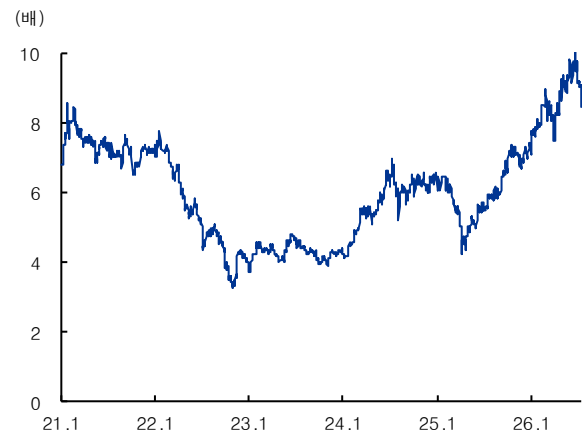
이번 CAPEX 상향의 주 요인은 장비 단가 상승이 아니라 고객사의 요청이다. TSMC는 신규 fab 투자 전 고객사 및 고객사의 고객과 수년 단위 로드맵을 사전 공유한다. 가시화된 수요를 근거로 투자한다는 의미이다. 3nm 이하 수요는 공급 대비 30~50% 이상 많은 것으로 파악된다. 공급부족은 2027년말에도 지속될 전망이다. 이번 증설은 선제적 투자가 아니라 이미 확인된 수요에 대한 대응이라는 점에서 중장기 실적 성장으로 이어질 가능성이 높다고 판단한다.

그림 7. TSMC 12m fwd PER 추이



자료: Bloomberg, IBK투자증권

그림 8. TSMC 12m fwd PBR 추이



자료: Bloomberg, IBK투자증권

Q&A

Q1. 26~28년 3개년 CAPEX 가이드스

A1. 구체 수치는 없음. 다만 향후 3년 CAPEX는 과거 3년 대비 더욱 크게 증가할 것

Q2. 애리조나 추가 1,000억USD 투자로 애리조나에 총 2,650억USD를 투자하게 됐는데 향후 CAPA 계획은?

A2. 일정은 시장 상황에 달림. 추가로 4개 이상 fab 건설 예상, 전공정 + 후공정 모두 포함

Q3. 삼성전자의 메모리 호실적, Intel의 정부 지원 등 경쟁 심화 우려는?

A3. 정부 지원은 동사도 받고 있음. 경쟁 인지하고 있으나 기술력·제조 역량·고객 신뢰 3박자가 핵심이며 지름길 없음

Q4. Agentic AI 반영해 AI 반도체 5개년 CAGR(기존 mid~high 50%대) 상향 조정하나?

A4. 구체 수치는 없으나 성장세는 점점 더 강해지고 있음

Q5. EMIB-T 등 신규 패키징 기술 경쟁 위협은?

A5. 우리 패키징 CAPA가 타이트해 신규 기술이 성공할 경우 우리의 부담을 덜어줄 것. 이러한 추가 대안과 유연성을 환영하는 입장

Q6. CAPA 확장 시 경쟁 압력·데이터센터 지연 등 변수 고려하는지?

A6. 경쟁 상황 최우선 고려. 고객 및 고객의 고객(CSP) 수요를 종합 판단해 CAPA 결정. 결정은 매우 신중하게 이루어짐. 데이터센터 진행 상황도 모니터링해 재고가 쌓이지 않도록 노력 중

Q7. 내년 말까지도 공급 부족 지속되나?

A7. 중간에 일시적인 둔화가 나타날 수 있으나, 2029~2030년까지 수요는 매우 강할 것. AI가 자동차·로봇 등 전 산업에 영향을 미치는 새로운 산업으로 자리 잡으면서 관련 수요가 지속될 것으로 전망.

Q8. 메모리 대비 수익성이 낮는데 수익성 목표 상향 여지는?

A8. 우리는 파트너임. 고객의 성공을 중요하게 생각함. 가격을 급격하게 올리면 고객도 살아남을 수 없음. 우리는 가치를 창출하고 장기적 성장에 필요한 이익과 수익률을 확보하기 위해 노력함

Q9. 상위 5개 고객 의존도가 높아지고 있는데 관련 리스크는?

A9. 관련해서 우려 사항은 없음. 대형 고객사의 성장을 긍정적으로 보고 있고, 일부 고객사는 매우 빠르게 성장 중. AI 산업 내 신규 플레이어도 계속 늘어나고 있음

Q10. 고객사에 대한 직접 투자/파이낸싱 계획 있는지?

A10. 없음. 현재 협력 모델이 원활히 작동 중

Q11. 애리조나 추가 1,000억USD 투자 일정은?

A11. 계획은 있으나 시장 상황 및 고객 수요에 따라 달라질 수 있어 확정 일정을 언급하기는 어려움. 최대한 신속히 진행하려 노력 중. 수요와 공급의 격차를 줄이기 위해 노력하고 있음

Q12. COUPE 플랫폼의 매출 기여 시점은?

A12. 이미 생산을 시작했고, 생산량을 늘려갈 것. 향후 데이터센터의 전력·대역폭 요구 증가에 따라 수요가 계속 늘어나고 몇 년 내에 중요한 기술이 될 것으로 기대

Q13. AI 내 GPU 가속기, CPU 등 전망

A13. 구체 수치는 없음. 해당 칩들은 모두 TSMC에서 생산하고 있음. CPU / GPU / XPU 등 공급 비중은 고객과 조율 중임

Q14. 유리기판 / 코어 등 차세대 패키징(CoWoS 대안) 진행 상황은?

A14. 현재 주력은 여전히 CoWoS임. 대안을 개발하고 비용을 낮추기 위해 노력하고 있고, 약 1년 후 고객사 제품에 양산 적용 기대

Q15. 올해 CAPEX 확대를 주도하는 것은 Cloud Computing인가 아니면 Edge Computing인가? 아니면 단순 장비 가격 인상인지

A15. 올해 CAPEX 확대는 모두 AI와 관련

Q16. 후공정 경쟁 심화(Intel EMIB-T 등)로 전공정까지 잠식될 우려는?

A16. 전공정·후공정은 완전히 별개 사업. 우리의 후공정 CAPA도 타이트해 경쟁사가 패키징을 제공한다면 우리 wafer 사업에도 도움이 될 것

Q17. High-NA EUV의 die stitching 이슈가 도입 지연시키나?

A17. High-NA의 필드 사이즈가 기존 대비 1/2 수준이라는 건 인지하고 있음. 해당 부분을 제조비용 산정에 반영하고 있고, ASML과 협업을 통해 비용과 기술 성숙도 측면에서 양산에 적합하도록 개선하려고 노력 중. 성숙도·비용 종합 고려해 도입 여부 결정

Q18. 3nm 이하 수요가 공급 대비 30~50% 이상 초과하나?

A18. 공유 가능한 수치는 없음. 다만, 실제로 수요와 공급의 차이는 매우 큼

Q19. 2nm CAPA CAGR(~70%, 26~28년), N3+N5 CAGR(~25%, 22~27년) 여전히 유효한지?

A19. 더 커졌음

Q20. Advanced Packaging · 테스트 · 마스크 제조 등 후공정 관련 CAPEX(전체의 10~20%) 중 순수 패키징 비중만 별도 분리 가능한지?

A20. 전공정 / 후공정 간 유동적 배분(병목 발생 시 그쪽에 우선 투입)이라 세부 분리 어려움, 범위는 10~20% 유지

Q21. CAPEX가 6개월 전 대비 약 100억USD 상향된 배경은?

A21. 고객 수요 증가 및 고객사의 증설 요청이 주 요인. 인플레이션으로 인한 장비 가격 상승 영향도 있음

Q22. Consumer 부문 수요가 약세인 상황에서 Legacy 공정 수급 상황은?

A22. 전력관리IC, 센서와 같은 AI 관련 Legacy만 공급 부족. 그 외 일반 Consumer향은 수요 약세

각 증권사별 투자의견

표 2. 주요 업체 TSMC 투자의견

일자	기업명	투자의견	목표주가
2026-07-15	Wedbush	outperform	2900.00
2026-07-15	Itau BBA Securities	outperform	2051.00
2026-07-15	China Renaissance Research	buy	3190.00
2026-07-14	Masterlink Securities	buy	3200.00
2026-07-14	IBF Securities Investment Consulting	buy	2700.00
2026-07-13	Morgan Stanley	Overwt/Attractive	2888.00
2026-07-13	UBS	buy	3400.00
2026-07-13	Bernstein	outperform	2780.00
2026-07-12	HSBC	buy	3350.00
2026-07-09	JP Morgan	overweight	3100.00
2026-07-09	Banco Safra	outperform	3300.00
2026-07-08	Fubon Securities	buy	3500.00
2026-07-07	GF Securities Co. Ltd.	buy	2900.00
2026-07-06	Yuantia	buy	3200.00
2026-07-03	Goldman Sachs	buy	3000.00
2026-07-03	Citi	buy	3800.00
2026-07-03	Macquarie	outperform	3380.00
2026-07-02	BOC International Holdings Ltd.	buy	3450.00
2026-07-02	SinoPac Securities	buy	3090.00
2026-07-01	KGI Securities Co Ltd	outperform	3000.00
2026-07-01	Nomura	buy	3425.00
2026-06-30	Mizuho Securities	buy	3000.00
2026-06-29	CLSA	buy	3330.00
2026-06-22	Susquehanna	Positive	3150.00
2026-06-16	Arete Research	buy	3354.00
2026-06-16	New Street Research LLP	buy	2780.00
2026-06-15	Aletheia Capital Limited	buy	3500.00
2026-05-31	TD Cowen	hold	2250.00
2026-05-26	Morningstar	buy	2700.00
2026-05-19	BNP Paribas	outperform	2520.00
2026-04-20	DBS Bank	buy	2400.00
2026-04-17	Capital Securities	buy	2635.00
2026-04-17	President Capital Management Corp	buy	2885.00
2026-04-17	Cathay Securities Corp., Taipei	strong buy	2710.00
2026-04-17	E Sun Securities	buy on weakness	2525.00
2026-04-17	CTBC Securities Investment Service Co	buy	2780.00
2026-04-16	Deutsche Bank	buy	2500.00
2026-04-16	Daiwa Securities	buy	2330.00

자료: Bloomberg, IBK투자증권

주1: 2026년 4월 이전 제외

주2: 2026.07.16 기준

Compliance Notice

동 자료에 게재된 내용들은 외부의 압력이나 부당한 간섭 없이 본인의 의견을 정확하게 반영하여 작성되었음을 확인합니다.

동 자료는 기관투자자 또는 제3자에게 사전 제공한 사실이 없습니다.

동 자료는 조사분석자료 작성에 참여한 외부인(계열회사 및 그 임직원등)이 없습니다.

조사분석 담당자 및 배우자는 해당종목과 재산적 이해관계가 없습니다.

동자료에 언급된 종목의 지분율 1%이상 보유하고 있지 않습니다.

당사는 상기 명시한 사항 외 고지해야 하는 특별한 이해관계가 없습니다.

종목명	담당자	담당자(배우자) 보유여부			1%이상	유가증권	계열사	공개매수	IPO	회사채	중대한	M&A
		수량	취득가	취득일	보유여부	발행관련	관계여부	사무취급		지급보증	이해관계	
해당 사항 없음												